



三井金属鉱業株式会社 三井金属

東京都品川区大崎 1-11-1
郵便番号 141-8584

2008 年 4 月 25 日

各 位

三井金属 電解銅箔（薄物）の生産能力をアジアにおいて大幅増強

～台湾、マレーシアの各拠点にて新規ラインを増設～

当社 三井金属(社長 竹林義彦)は、このたび電解銅箔事業において、厚さ 18 マイクロメートル以下の薄物商品の生産能力を大幅に増強いたします。特に、極薄とされる厚さ 12 マイクロメートルの銅箔の生産能力を倍増すると共に、需要が堅調な樹脂付き銅箔(※1)についても増産を行い安定的な供給体制を構築いたします。

<マレーシア・台湾の各拠点において増産実施>

今回実施する電解銅箔の増産は、アジアにおける 2 箇所の量産拠点を対象にしています。一つは、台湾にある台湾銅箔股份有限公司(以下、TCF)と、もう一箇所がマレーシアにある Mitsui Copper Foil (MALAYSIA) SDN. BHD.(以下、MCF)において増産投資を行います。

TCFにおいては、設備の更新等により全体で 200t/月の増産を図ります。

さらに、表面処理の既存ラインの生産性向上と、新規の同ライン増設により 12 マイクロメートル厚の銅箔の生産能力を引き上げます。

同様に、MCFにおいても、表面処理工程において既存ラインの生産性を上げながら、新たに同ラインの増設を行い 12 マイクロメートル厚の銅箔の生産能力向上を図ります。

これらTCF・MCFを合わせた 12 マイクロメートル厚の銅箔の生産能力は、従来の約 2 倍に向上し 600t/月以上の生産が可能になります。両拠点における増設ラインは、この 4 月より稼働を開始しています。

加えて、MCFでは、樹脂付き銅箔の新ラインを増設します。新ラインの稼働を予定する 2009 年以降、MCFにおいて 50 万 m²/月(※2)の同銅箔の増産が可能となり、TCFと合わせた生産能力は、従来の約 1.5 倍にあたる 130 万 m²/月となります。

<投資金額>

今回のTCF・MCF両拠点における設備増強に対する投資額は、総額35億円です。当社の電解銅箔事業にとり、ITバブル崩壊後に実施した増産としては最大の投資額となります。

<増産の背景・市場動向>

電解銅箔は、電子機器プリント配線板用の積層材料に使用されます。顧客のニーズに応じ箔の

厚さの違いや、表面に施す特殊な加工によって各種商品に分かれますが、主に 12 マイクロメートルから 70 マイクロメートルの厚さの電解銅箔が使用されています。昨年来、アジア市場では、これまで主流の 35 マイクロメートル厚から薄物商品へと需要が移行しており、特に 12 マイクロメートル厚の銅箔に対する需要が急速に高まっています。

従来 12 マイクロメートル厚の銅箔は、精密回路が要求される IC パッケージ用途が主でしたが、携帯機器の小型化、高密度化にともない携帯電話、携帯音楽プレーヤーなどのマザーボード用途も増えていることから、アジア市場の需要増を引き起こす要因となっています。

また昨今、環境に配慮した加工法への転換が進む顧客先のプリント配線板メーカーでは、回路加工時に除去する銅の量を減らすため従来使用の 18 マイクロメートル厚より 30%以上も薄い 12 マイクロメートル厚の銅箔への要望が高まっていることも需要移行の背景となっています。

特に、携帯電話の需要は、年 7% 程度の堅調な伸びが期待でき、さらなる小型化、高密度化が進むものと考えられます。このため 12 マイクロメートル厚の樹脂付き銅箔の需要は、今後も堅調に増加するものと見込まれています。

<今後の展望>

当社は、これまで電解銅箔の薄物商品に対し安定的な量産を実現するため、12 マイクロメートル厚の銅箔、ならびに同銅箔を使用した樹脂付き銅箔など、各種商品の充実に取り組んできました。その結果、12 マイクロメートル厚の銅箔において当社は現在、アジア市場でシェア 50%前後というメジャーサプライヤーの地位を堅持するに至っています。また、樹脂付き銅箔においても当社は現在、世界市場で 60%前後のトップシェアを有しています。

いずれも今回の増産により、今後見込まれる需要増へ充分に応え得る体制をいち早く築き、一層の安定供給を図ってまいります。

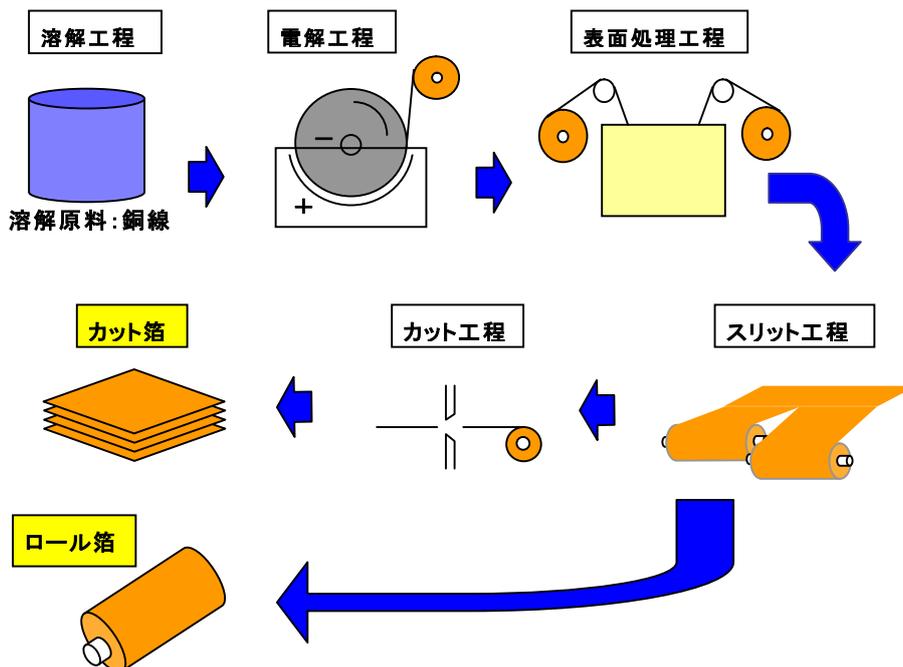
また当社は、環境対応の商品としてハロゲンフリー樹脂付き銅箔を 2003 年に市場に先駆け販売しております。以来、需要が拡大し、現在当社が販売する樹脂付き銅箔は、ハロゲンフリー品が大部分を占めます。今後、中国をはじめアジア諸国で環境規制が強化される中、環境と共存しつつ精密回路の加工性にも優れた当社の 12 マイクロメートル厚の樹脂付き銅箔の需要は、着実に伸びていくものと見込まれます。

※1. 樹脂付き銅箔…主に 12 マイクロメートル銅箔にエポキシ樹脂を塗布した商品。レーザービーム加工性の高さにより、主に携帯電話などに使用される高密度ビルドアップ多層板に使用されております。

※2. 50 万 m²/月 …商品によっては、重量で表すより箔の面積で表す方が生産量の実態に即している場合がある。

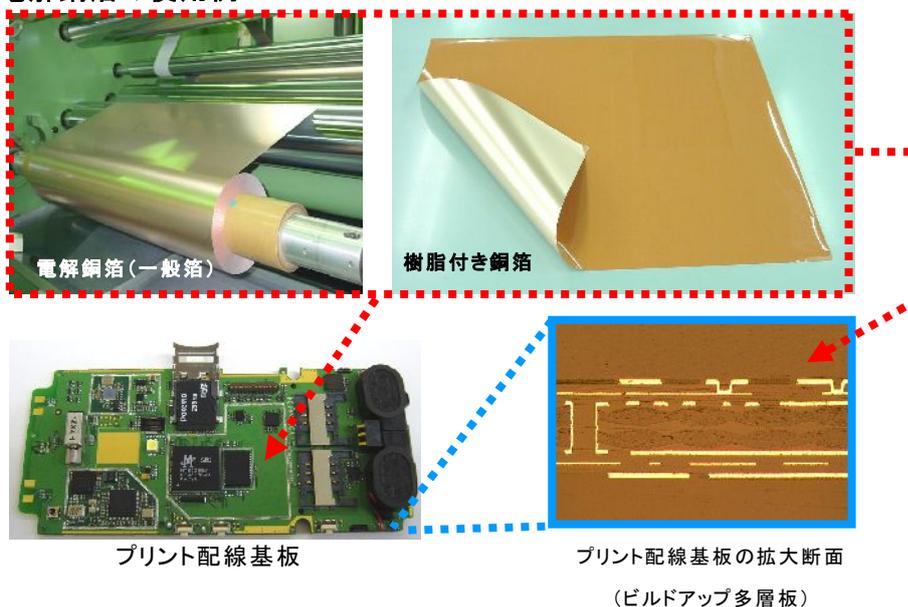
【ご参考】

1. 電解銅箔の製造工程



※樹脂付き銅箔は、別工程において上記ロール箔の表面に樹脂を塗工し製造されます。

2. 電解銅箔の使用例



※ 各種電解銅箔は、プリント配線基板の配線材料として使用されます。

以 上

【本件お問い合わせ先】

三井金属 経営企画部広報室

TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール PR@mitsui-kinzoku.co.jp